

発表開始時間	発表終了時間	会場	セッションNO	発表順	セッション名	演題名	座長	氏名	所属
12:55	13:00	U-ホール	半導体再生特別セッション		テーマ：「緊急企画：日本半導体産業再生の最後の機会を逃さないために、今、後工程・実装業界がすべきこと」 ～今後の業界構造を激変させるMore Than Moore、チップレット、光電融合などの動きにどう備えるか～				
13:00	13:50	U-ホール	5U	2	1	国家戦略としての半導体再生、施策、企業はどう動くべきか（仮）	齊藤文靖（大阪公立大学）	新沼 祐	経済産業省
13:50	14:30	U-ホール	5U	2	2	世界から見たパッケージ技術での日本の強みと今後のビジネスチャンスとリスク	齊藤文靖（大阪公立大学）	亀和田忠司	AZ Supply Chain Solutions
14:30	15:10	U-ホール	5U	2	3	最先端パッケージの世界動向：チップレットを中心として（仮）	齊藤文靖（大阪公立大学）	西尾俊彦	㈱SBRテクノロジー
15:25	16:05	U-ホール	5U	3	1	調整中	齊藤文靖（大阪公立大学）	（調整中）	NTT
16:05	16:55	U-ホール	5U	3	2	More Than Mooreは半導体業界の再生の機会、チップレット化で激変の業界構造とモノづくり	齊藤文靖（大阪公立大学）	若林秀樹	東京理科大学
17:00	18:00	U-ホール	5U	4	1	パネルディスカッション	齊藤文靖（大阪公立大学）	講演者、折井靖光（長瀬産業）、西田秀行（NEP Tech. S&S）	